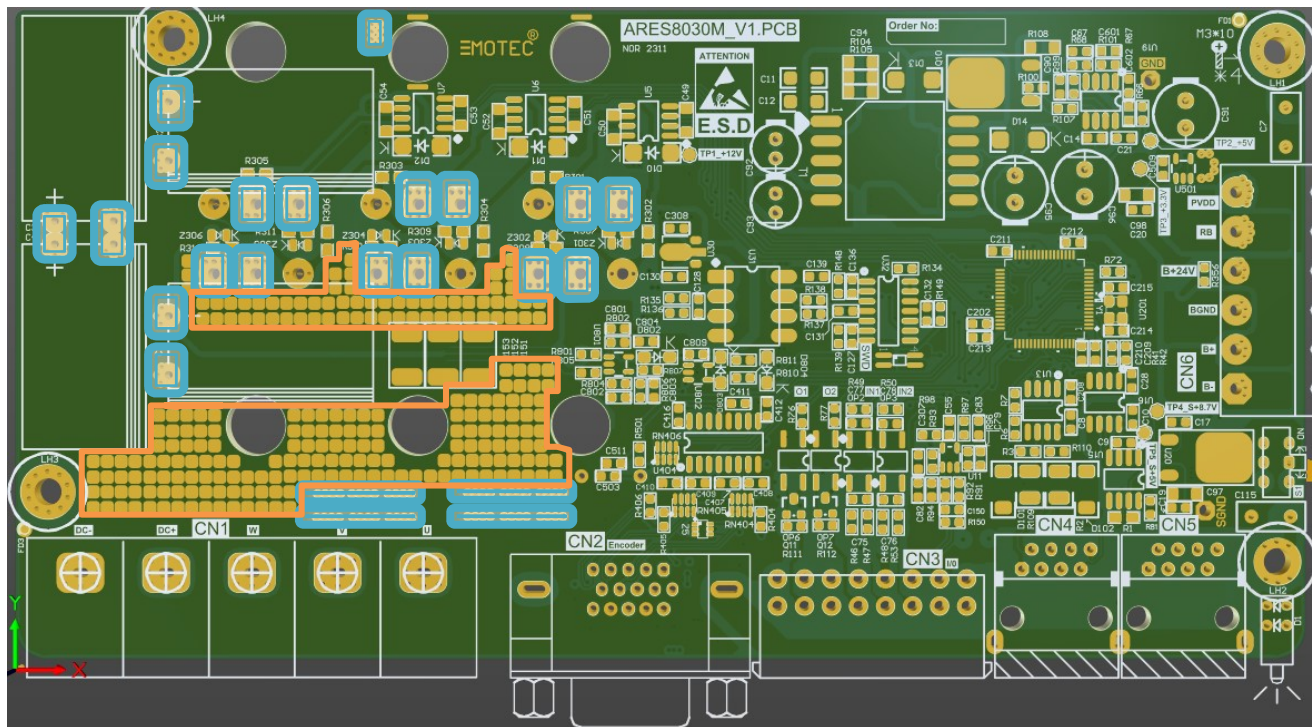


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES8030M_V1	焊接	QM033231115	V1	1/2	20231115

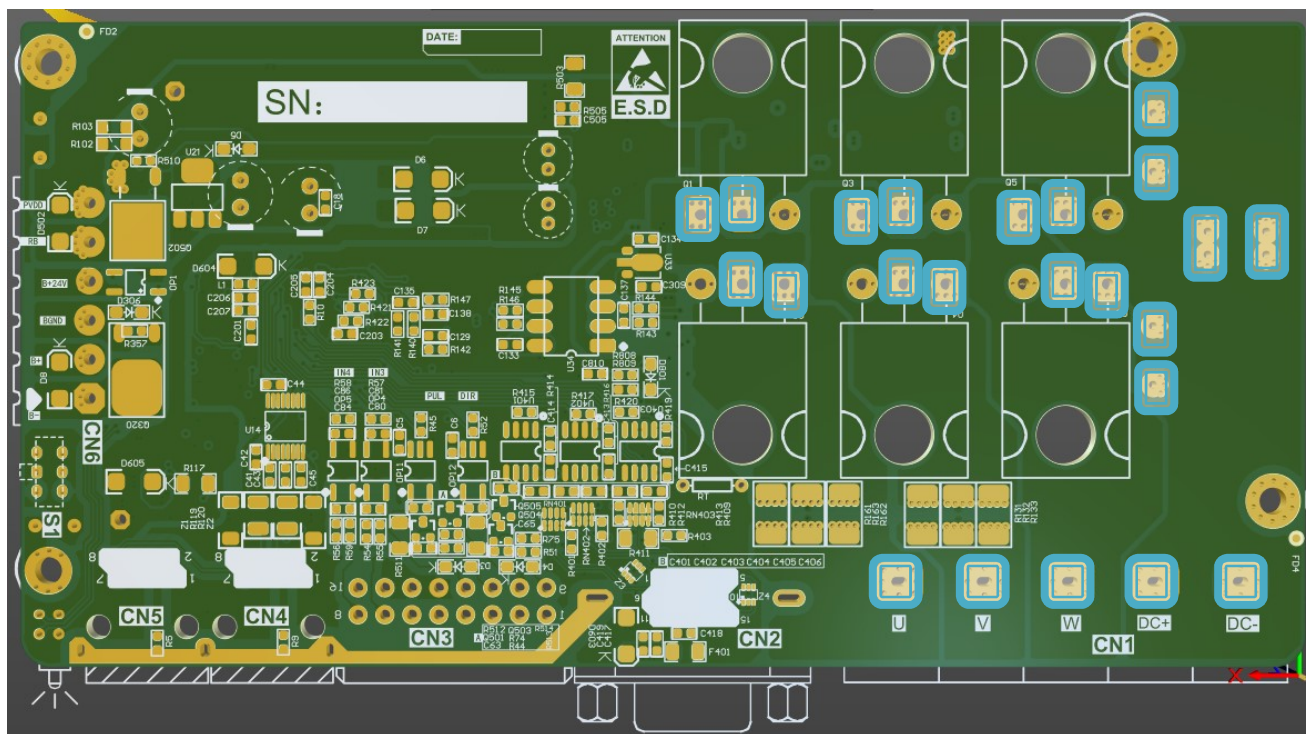
### 1. ARES8030M\_V1 加锡位置

顶层



- 1) 橙色框内 PAD 加锡，加锡厚度为 0.2mm；
- 2) 蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内上下焊锡通透（灌满焊锡）；

底层

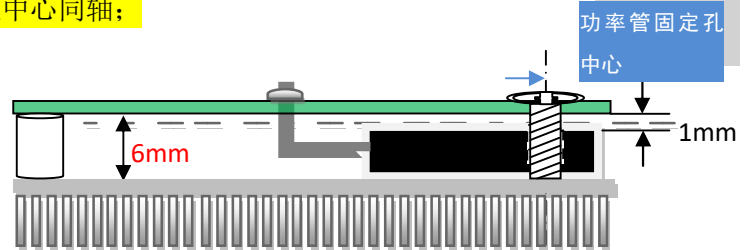


- 1) 蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内从底层至顶层注满焊锡；
- 2) CN1 端子，底层加锡焊接，焊锡熔化后，电烙铁仍要停留 2~3 秒，保证焊锡从过孔完全流到板子顶层。

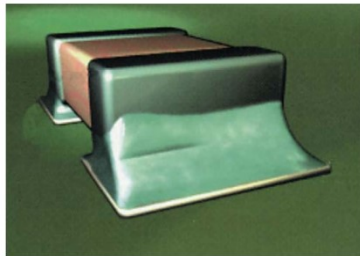
<b>PCB 焊接</b>	<b>产品名称</b>	<b>产品型号</b>	<b>工序</b>	<b>文件编号</b>	<b>版本</b>	<b>页数</b>	<b>制订时间</b>
<b>工艺要求</b>	直流伺服	ARES8030M_V1	焊接	QM033231115	V1	2/2	20231115

2. 焊接基本要求

- 1) 滑动开关 S1, 洗板时, 不要进入液体, 否则会影响使用  
(或者在洗完板后焊接 S1, 之后用小刷子沾洗板水, 局部清理焊接的管脚)
- 2) 功率管 Q1~Q6 共计 6 个 (TO-247 封装的管子), 管脚直角折弯,
  - a) **高度: 功率管的下表面 (金属部分) 距离 PCB 下表面 6mm 焊接; 且要求功率管脚顶层和底层双面焊接;**
  - b) **焊接后, 功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴;**

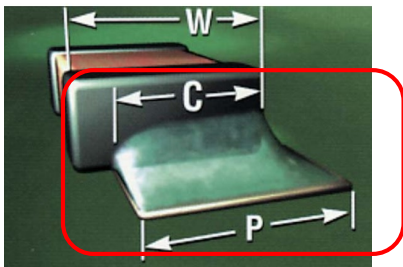


- 3) 电阻 R131, R132, R133, R161, R162, R163, R151, R152, R153 要求焊接完成后, 保证元件不偏移, 见下图  
(元件的电极与相应焊盘位置重叠)



目标 - 1, 2, 3级  
 • 末端连接宽度等于元器件端子宽度或焊盘宽度, 取两者中的较小者。

**可接受:** a) 端子 (A) 的侧面偏移不大于端子宽度的 5% (约 0.15mm, 下图为焊接不良图片)。  
 b) 端子连接宽度在与焊盘接触区域有 100% 润湿



**备注:** 该位置要求 100% 目检, 不符合要求的, 拒收!

- 4) 从底层焊接面焊接 CN1 黑色栅栏端子, 焊锡要透到顶层元件面;
- 5) 电解电容 C1~C4:
  - A) 按照丝印标识折弯管脚, 卧式贴线路板焊接, **注意 C4 电解折弯方向相反;**
  - B) C1~C4 电解电容与 PCB 接触面涂覆 704 黑色固定胶, **点胶不要过量;**
- 6) 变压器 T1 焊接前, 要对管脚的平整度进行调整, 避免出现管脚虚焊和变压器焊接后, 不在同一平面上;
- 7) 所有端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 8) 所有极性元件, 严禁方向反;
- 9) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 10) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 11) 手工操作要做防静电处理;
- 12) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;
- 13) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

<b>编制</b>		<b>审核</b>		<b>批准</b>	
日期		日期		日期	